

Semicon Japan 2015 参展通知（日本电产理德）

2015 年 12 月 9 日

我司将于 2015 年 12 月 16 日（星期三）至 18 日（星期五），参加在东京·江东区举办的 Semicon Japan 2015。本次展会中，我司主要展出对应 60 μ m 的全世界直径最小的「MEMS 弹簧探针/制造装置」、「半导体晶片 bump 光学检测装置」，同时为您介绍最先进的检测解决方案。此外，本次展会的另外一大主题是向大家介绍对应「IoT」的新产品。根据客户的需求，提供最合理的检测解决方案是我们的使命。欢迎各位莅临我司展位。

【主要展示内容】

- 光学式检测装置「RWi-300 系列」
- 面向探针卡的「MEMS 弹簧探针/制造装置」及其他
- 对应 IoT 化的解决方案「IDEAS」及其他

会场：东京国际展览中心

会期：2015 年 12 月 16 日(周三)~18 日(周五)

展示位：1708

公式 HP：<http://www.semiconjapan.org/en/>